De English Equivalent US 5, 135, 960

# SILICONE RUBBER SPONGE COMPOSITION

Publication number: JP7247436

Publication date:

1995-09-26

Inventor:

HIGUCHI KAZUO; NAKAMURA AKITO

**Applicant:** 

DOW CORNING TORAY SILICONE

Classification:

- international:

C08L83/05: C08J9/06: C08K9/10: C08L83/04;

C08L83/07; C08J9/00; C08K9/00; C08L83/00; (IPC1-7):

C08L83/07: C08L83/05

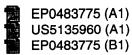
- European:

C08K9/10; C08L83/04

Application number: JP19910126669 19910430

Priority number(s): JP19910126669 19910430; JP19900293217 19901030

Also published as:



Report a data error here

## Abstract of JP7247436

PURPOSE:To obtain the subject composition consisting of specific organopolysiloxane raw rubber, an organohydrodienepoly-siloxane, etc., having long pot life and having uniform and fine cells after curing. CONSTITUTION:This composition consists of (A) 100 pts.wt. of an organopolysiloxane raw rubber expressed by an average composition of the formula [R is a (substituted)monovalent hydrocarbon; (a) is 1.8-2.3] and having at least two alkenyl groups bonded to Si atom in one molecule, (B) 0.1-10 pts.wt. of an organohydrodienepolysiloxane having at least two hydrogen atoms bonded to Si atom in one molecule, (C) 5-150 pts.wt. of an inorganic filler, (D) 0.5-20 pts.wt. of an organic foaming agent and (E) a catalytic amount of a thermoplastic resin fine particle catalyst (having softening point of a thermoplastic resin of 50-250 deg.C and average particle diameter of the thermoplastic resin fine particle catalyst of 0.01-100mum) containing >=0.01wt.% (as a platinum metal atom) of a platinum-based catalyst.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-247436

(43)公開日 平成7年(1995)9月26日

(51) Int.Cl.6

庁内整理番号 識別記号

FΙ

技術表示箇所

C08L 83/07

LRP

83/05

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 5 頁)

(21)出職番号

特惠平3-126669

(22)出顧日

平成3年(1991)4月30日

(31) 優先権主張番号 特顯平2-293217

(32) 優先日

平2(1990)10月30日

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出顧人 000110077

東レ・ダウコーニング・シリコーン株式会

東京都中央区日本橋室町2丁目3番16号

(72)発明者 樋口 和男

千葉県市原市有秋台西1丁目6番地

(72)発明者 中村 明人

千葉県市原市有秋台西1丁目6番地

(54) 【発明の名称】 シリコーンゴムスポンジ組成物

## (57) 【要約】

【目的】 加熱により硬化して微細かつ均一なシリコー ンゴムスポンジとなり得るシリコーンゴムスポンジ組成 物を提供する。

【構成】 (A) アルケニル基を有するオルガノポリシ ロキサン生ゴム、(B) オルガノハイドロジェンポリシ ロキサン、(C)無機質充填剤、(D)有機発泡剤およ び(E) 白金系触媒を白金金属原子として0.01重量 %以上含有する熱可塑性樹脂微粒子触媒からなる、シリ コーンゴムスポンジ組成物。

10

## 【特許請求の範囲】

(A) 平均組成式 RaSiO 【請求項1】 (4-4)/2 (式中、Rは置換または非置換の1価炭化水素 基、aは1.8~2.3の数である。) で示され、1分 子中に、少なくとも2個のケイ素原子結合アルケニル基 を有するオルガノポリシロキサン生ゴム 100重量 部、(B) 1分子中に、少なくとも2個のケイ楽原子結 合水素原子を有するオルガノハイドロジェンポリシロキ サン 0.1~10重量部、(C)無機質充填剤 5~ 150重量部、(D) 有機発泡剤 0.5~20重量 部、および(E)白金系触媒を白金金属原子として0. 0 1 重量%以上含有する熱可塑性樹脂微粒子触媒(ここ で、該熱可塑性樹脂の軟化点は50~250℃であり、 熱可塑性樹脂微粒子触媒の平均粒子径は0.01~10 0 μmである。) 触媒量からなる、シリコーンゴムス ポンジ組成物。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はシリコーンゴムスポンジ組成物に関するものであり、詳しくは、加熱により硬化 20 して微細かつ均一なセルを有するシリコーンゴムスポンジになり得るシリコーンゴムスポンジ組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】シリコーンゴムスポンジは、シリコーンゴム組成物に有機系発泡剤を添加して、その分解速度すなわち発泡速度に合った硬化方法により硬化させることにより製造されている。硬化方法としては有機過酸化物により硬化させる方法およびメチルハイドロジェンポリシロキサンを架橋剤として白金系触媒により硬化させる付加型硬化方法などが知られている。前者の有機過酸化物により硬化される方法の場合には、硬化に要する時間が長いために微細かつ均一なセルを有するシリコーンゴムスポンジを得ることが難しかった。また導電性カーボンプラックを配合したシリコーンゴム組成物についてはその硬化が不十分であり、導電性シリコーンゴムスポンジを得ることは実質的に不可能であった。

【0003】また、後者の白金系触媒により硬化させる方法は、白金系触媒の触媒活性が高いので、可使時間が短く、特に硬化速度と発泡速度のパランスを取ることが40難しいので、微細かつ均一なセル構造を有するシリコーンゴムスポンジを得ることが難しかった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】発明者らは上記問題点 を解決するため、鋭意研究した結果、本発明に到達し た。

【0005】本発明の目的は、加熱により硬化して微細かつ均一なシリコーンゴムスポンジとなり得るシリコーンゴムスポンジとなり得るシリコーンゴムスポンジ組成物を提供するにある。

[0006]

【課題の解決手段とその作用】本発明は、(A) 平均組成式 R<sub>1</sub>SiO(4-1)/2</sub> (式中、Rは置換または非置換の1価炭化水素基、aは1.8~2.3の数である。)で示され、1分子中に、少なくとも2個のケイ素原子結合アルケニル基を有するオルガノボリシロキサン生ゴム100重量部、(B) 1分子中に、少なくとも2個のケイ素原子結合水素原子を有するオルガノハイドロジェンボリシロキサン 0.1~10重量部、(C)無機質充填剤 5~150重量部、(D) 有機発泡剤 0.5~20重量部、および(E) 白金系触媒を白金金属原子として0.01重量米以上含有する熱可塑性樹脂微粒子触媒(ここで、該熱可塑性樹脂の軟化点は50~250℃であり、該熱可塑性樹粒子触媒の平均粒子径は0.01~100μmである。) 触媒量からなる、シリコー

【0007】これを説明すると、本発明に使用される(A)成分のオルガノポリシロキサン生ゴムは、本発明組成物の主剤となる成分であり、1分子中に、少なくとも2個のケイ素原子結合アルケニル基を有することが必要である。このオルガノポリシロキサンは、上式中、Rはメチル基、エチル基、プロピル基、プチル基、ヘキシル基、オクチル基などのアルキル基;ピニル基、アリル基、ヘキセニル基などのアルケニル基;フェニル基などのアリール基;3、3、3ートリフルオロプロピル基などの置換炭化水素基で例示される置換または非置換の1価炭化水素基であり、aは1.8~2.3の数である。

ンゴムスポンジ組成物に関する。

【0008】このオルガノポリシロキサン生ゴムの分子 構造は直鎖状であることが好ましいが、分枝状のシロキ サン骨格を少量含有するものでもよい。またその重合度 は特に限定されないが、当業界においてオルガノポリシ ロキサン生ゴムと呼称されている範囲内のものであり、 通常25℃における粘度が10<sup>7</sup>センチストークス以 上、平均分子量25×10<sup>4</sup>以上ものが好ましく使用さ れる。

【0009】本発明に使用される(B)成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンは、(A)成分のオルガノポリシロキサン生ゴムの架橋剤であり、本発明組成物が網状構造を形成するためには、1分子中に、少なくとも2個のケイ素原子結合水素原子を有することが必要である。水素原子以外にケイ素原子に結合した有機基としては、前述した(A)成分のオルガノポリシロキサン生ゴムのRとして例示した置換または非置換の1価炭化水素基と同様のものが例示される。この有機基は、1分子中に1種のみでもよく、また2種以上が混在していてもよい。このオルガノハイドロジェンポリシロナンの分子構造は、直鎖構造、網状構造、または3次元構造を含んでいてもよく、これらの単一重合体または共重合体もしくは2種以上の重合体の混合物も使用できる。

50 このオルガノハイドロジェンポリシロキサンの重合度

3

は、通常25℃における粘度が0.5~50,000セ ンチポイズの範囲であり、好ましくは1~10,000 センチポイズの範囲内のものが使用される。またその配 合量は本成分のケイ素原子結合水素原子と(A)成分の ケイ素原子結合アルケニル基のモル比が0.5/1~1 0/1の範囲内になるような量であり、好ましくは1/ 1~10/1の範囲内である。

【0010】(C)成分の無機質充填剤は、従来からシ リコーンゴムに使用されているもので良く、特に限定さ れない。このような無機質充填剤としてはヒュームドシ 10 リカ、沈降法シリカ、オルガノシランやオルガノシロキ サンで疎水化処理されたシリカ、溶融シリカ、石英粉 末、けいそう土、炭酸カルシウム、アルミナ、カーボン ブラックなどが例示される。(C)成分の配合量は (A) 成分100重量部に対して5~150重量部であ り、好ましくは20~80重量部である。

【0011】(D)成分の有機発泡剤は、従来からシリ コーンゴムに使用されているものでも良く、特に限定さ れない。このような有機発泡剤としてはアゾビスイソブ チロニトリル, アゾジカルポンアミド, ジニトロソペン 20 タメチレンテトラミン, 4,4'-オキシピスペンゼンス ルホニルヒドラジッド、パラトルエンスルホニルヒドラ ジッドなどが例示される。

【0012】本発明に使用される(E)成分の熱可塑性 樹脂微粒子触媒は、本発明を特徴づける成分である。こ のような(E)成分は、白金系触媒を白金金属原子とし て0.01重量%以上含有する熱可塑性樹脂からなる微 粒子触媒である。この熱可塑性樹脂微粒子触媒とは、熱 可塑性樹脂の殻の中に白金系触媒が核として含有されて いる構造の微粒子あるいは微粒子状熱可塑性樹脂の中に 30 ることが好ましい。 白金系触媒が溶解または分散している構造の微粒子を意 味する。また、この白金系触媒は、ヒドロシリル化反応 を促進する触媒活性をもつ白金系金属自体、白金系化合 物またはこの白金系化合物を主成分とする組成物であ る。このようなヒドロシリル化反応用白金系触媒として は、白金微粉末、塩化白金融、アルコール変性塩化白金 酸、白金とジケトンの錯体、塩化白金酸とオレフィン類 の錯体、塩化白金酸とアルケニルシロキサンの錯体、お よびこれらをアルミナ、シリカ、カーボンプラックなど の担体に担持させたものが例示される。これらの中でも 40 塩化白金酸とジビニルシロキサンの錯体触媒がヒドロシ リル化反応用触媒としての触媒活性が高いので好まし W.

【0013】(E)成分に使用される熱可塑性樹脂は、 軟化点が50~250℃の温度範囲内にあることが必要 である。これは軟化点が50℃未満であると、これをヒ ドロシリル化反応によって硬化するシリコーンゴム組成 物に添加した後のシリコーンゴム組成物の貯蔵安定性が 著しく低下し、また250℃を超えると触媒活性が発現 する温度が高過ぎて、実質的に触媒としての機能を果た 50 などの硬化補助剤も必要に応じて添加してもよい。また

さなくなるからである。この点から、この熱可塑性樹脂 の軟化点は50~200℃の温度範囲内にあることが好 ましく、70~150℃の温度範囲内にあることがより 好ましい。

【0014】このような(E)成分は、白金系触媒が、 軟化点が50~200℃の範囲内にある熱可塑性樹脂中 に含有されたものであるが、ここで使用される熱可塑性 樹脂は白金系触媒を実質的に透過させず、かつ、(A) 成分のオルガノポリシロキサン生ゴムに実質的に溶解し ない限りいかなる熱可塑性樹脂が使用できる。(E)成 分に使用できる熱可塑性樹脂としては、例えば、シリコ ーン樹脂、ポリシラン樹脂、ポリスチレン樹脂、アクリ ル樹脂、メチルセルロース樹脂などが挙げれる。これら の中でも、熱可塑性シリコーン樹脂が好ましい。このよ うな白金系触媒含有熱可塑性微粒子触媒を製造する方法 としては、界面重合法やin-situ重合法などの化 学的方法、コアセルペーション法や液中乾燥法などの物 理化学的方法、スプレードライ法などの物理的、機械的 方法があり、本発明においてはいずれの手段を用いても よい。なかでも狭い粒系分布の微粒子が比較的容易に得 られることから、液中乾燥法とスプレードライ法が望ま しい。

【0015】(E)成分の平均粒子径は、0.01~1  $0.0 \mu m$ の範囲内であり、好ましくは $0.1 \sim 1.0 \mu m$ の範囲内である。これは平均粒子径が0.01μmより 小さくなると製造に際して白金系触媒の収率が大幅に低 下するからであり、100μmよりも大きくなると、

(A) 成分のオルガノポリシロキサン生ゴムへの分散安 定性が損われるからである。また、その形状は球状であ

【0016】白金系触媒の熱可塑性樹脂に対する比率 は、(E)成分中に占める白金系触媒の含有率が0.0 1重量%以上となる比率である。これは、0.01重量 %未満になると、本発明組成物に占める熱可塑性樹脂の 比率が高くなり過ぎ、硬化後の物性が振われることがあ るためである。

【0017】このような(E)成分の配合量は触媒量で あり、具体的には、(A)成分のオルガノポリシロキサ ン生ゴム100重量部に対して、白金金属原子換算で 0.00001~0.1重量部の範囲内でありことが 好ましく、0.00005~0.01重量部の範囲内で あることがさらに好ましく、また(E)成分そのものの 配合量は、(A)成分100重量部に対して0.005 重量部~100重量部の範囲であることが好ましい。

【0018】本発明の組成物は上記(A)~(E)成分 からなるシリコーンゴムスポンジ組成物であるが、これ ら(A)~(E)成分に加えて必要に応じてペンゾトリ アゾール、アセチレン系化合物、ハイドロパーオキシ化 合物などの反応抑制剤を添加してもよく、有機過酸化物

5

顔料や耐熱剤など従来からシリコーンゴムに使用されて いる添加剤を添加しても良い。このような添加剤として は、カーボンプラック、酸化鉄、酸化チタン、酸化亜 鉛、酸化マグネシウム、希土類酸化物、希土類水酸化 物、セリウムシラノレート、ステアリン酸などの脂肪族 もしくは脂肪酸塩などが例示される。

【0019】本発明組成物は、上記(A)成分~(E) 成分を均一に混合することによって容易に得られる。こ の混合の順序に特に制限はないが、(D)成分および (E) 成分は、少量の(A) 成分中に混合して均一分散 10 させた後、これらを(A)成分、(B)および(C)の 混合物の添加する方法が望ましい。また、(E)成分の 球状微粒子触媒の温度による破壊を防ぐために、混合す る時は(E)成分の熱可塑性樹脂の軟化点以下で混合す ることが好ましい。

[0020]

【実施例】次に本発明を実施例および参考例にて説明す る。実施例中、部とあるのは重量部のことであり、粘度 は25℃における値である。

[0021]

## 【参考例1】

#### 白金ビニルシロキサン錯体組成物の調製

6 gの塩化白金酸水溶液(白金含有量33重量%)と1 6gの1,3-ジビニルテトラメチルジシロキサンを3 5gのイソプロピルアルコールに溶解した。この溶液に 10gの重炭酸ソーダを加えて懸濁状態で攪拌しながら 70~80℃で30分反応させた。イソプロピルアルコ ールと水を圧力50mmIg、温度45℃の条件下で揮発除 去し、固形分を濾過することによって白金含有量9.8 ジピニルテトラメチルジシロキサン溶液を調製した。

[0022]

## 【参考例2】

### 熱可塑性シリコーン樹脂の調製

332gのフェニルトリクロロシラン、53gのジメチ ルジクロロシランおよび110gのジフェニルジクロロ シランを150gのトルエンで希釈した溶液を、430 gのトルエンと142gのメチルエチルケトンと114 gの水からなる液中に滴下して加水分解した。この反応 混合物を水洗いして塩化水素を除去してから有機相を分 40 ノポリシロキサン生ゴム(重合度3000)100部、 離し、さらに加熱してメチルエチルケトンを除去した。 次いで0.2gの水酸カリウムを加えて加熱し、発生す る水を留去した後、酢酸で中和して水洗いを繰返した。 しかる後、溶媒を乾固して熱可塑性シリコーン樹脂を得 た。この熱可塑性シリコーン樹脂のガラス転移点は65 ℃、軟化点は85℃であった。

[0023]

## 【参考例3】

## 熱可塑性樹脂微粒子触媒の調製

ガラス製の攪拌機付容器に、参考例2で調製した熱可塑 50 %)を1.0部を添加して混合後、さらに分解温度12

性シリコーン樹脂900gとトルエン500gとジクロ ロメタン4600gを投入し均一に混合した。次いで参 考例1で翻製した白金ピニルシロキサン錯体組成物4 4. 4gを投入し、混合することにより白金ピニルシロ キサン錯体と熱可塑性シリコーン樹脂の均一溶液を得 た。次いでこの溶液を流体ノズルを使って、窒素ガスを 熱気流にしたスプレードライヤー槽内に連続して噴霧し た。ここで、窒素ガスの熱気流温度はスプレードライヤ 一槽の入口で95℃であり、スプレードライヤー槽の出 ロで45℃であり、熱気流速度は1.3m³/minで あった。1時間の運転後パッグフィルターによって45 0 gの白金ピニルシロキサン錯体含有の熱可塑性シリコ ーン樹脂微粒子触媒を捕集した。この微粒子触媒の平均 粒子径は1.1μmであり、5μm以上の微粒子触媒の 含有量は 0.5重量%であった。またこの微粒子触媒の 形状を走査型電子顕微鏡により観察したところ、この微 粒子触媒は球状体であることが確認された。また、この 微粒子触媒に含まれる白金系触媒は、白金金属として約 0. 4重量%であった。

#### 20 [0024]

#### 【参考例4】

[0025]

熱可塑性メチルメタクリレート・プチルメタクリレート 共重合体微粒子触媒の調整

参考例3において、熱可塑性シリコーン樹脂の替わり に、軟化点115℃、ガラス転移点80℃のメチルメタ クリレート・プチルメタクリレート共重合体(デュポン 社製Elvacite2013)を使用した以外は参考 例3と同様にして、微粒子の製造を行い、1時間で51 0 gの白金ピニルシロキサン錯体組成物含有メチルメタ 重量%のピニルシロキサン配位白金錯体触媒の1、3-30 クリレート・プチルメタクリレート共重合体微粒子を得 た。この微粒子の平均粒子径は2.5 μmであり、10 μm以上の微粒子の含有量は2.0重量%であった。ま た、この微粒子中の白金含有量は0.39重量%であ り、この微粒子の形状を走査型電子顕微鏡で観察したと ころ、この微粒子は球状体であることが確認された。

> 【実施例1】ジメチルシロキサン単位99.85モル% とメチルピニルシロキサン単位0.15モル%からな り、両末端がトリメチルシロキシ基で封鎖されたオルガ ヒュームドシリカ40部、粘度80センチポイズの両末 端シラノール基封鎖ジメチルポリシロキサン10部を均 一混合した後、150℃で1時間加熱混合処理した。得 られた混合物を冷却した後、この組成物100重量部に 参考例3で翻製した熱可塑性シリコーン樹脂微粒子触媒 0.6部と1-エチニール-1-シクロヘキサン0.0 3部と粘度5センチポイズの両末端トリメチルシロキシ 基封鎖ジメチルシロキサンメチルハイドロジェンシロキ サン共重体(ケイ素原子結合水素原子含有量0.8重量

2℃のアゾジカルボンアミドとジニトロソペンタメチレ ンテトラミンの混合物からなる有機発泡剤「永和化成工 業株式会社製,商品名ピニホールAK#2]を2.0部 添加し均一になるまで混合してシリコーンゴムスポンジ 組成物を得た。

【0026】この組成物を200℃のオープンに入れ、 加熱硬化させたところスポンジ状硬化物が得られた。こ のスポンジ状硬化物を切断し、その切断面を顕微鏡にて 観察したところ、硬化物中に含まれるセルは、直径0. ジ状硬化物の発泡倍率は、2.6倍であり、その硬さは 10~13 (JIS A) であった。また、上記で得ら れたシリコーンゴムスポンジ組成物の可使時間および保 存安定性を調べるため、このシリコーンゴム組成物を室 湿にて24時間放置した。しかる後、この組成物につい て上記と同様の評価を行ったところ、得られたスポンジ 状硬化物中に含まれるセルは、直径0.05~0.3m mの範囲内にあった。

### [0027]

可塑性シリコーン樹脂球状微粒子触媒の替わりに、参考 例4で調製したメチルメタクリレート・プチルメタクリ レート共重合体微粒子触媒を使用した以外は実施例1と 同様にしてシリコーンゴムスポンジ組成物を得た。

【0028】この組成物を実施例1と同様にして硬化さ せ、スポンジ状硬化物中に含まれるセルを測定した。そ の結果、硬化物中に含まれるセルは直径0.05~0. 5mmの範囲内にあった。また、このスポンジ状硬化物 の発泡倍率は、2.8倍であり、その硬さは8~10 ーンゴムスポンジ組成物の可使時間および保存安定性を 調べるため、このシリコーンゴムスポンジ組成物を室温 にて24時間放置し、しかる後、この組成物について上 記と同様の評価を行ったところ、得られたスポンジ状硬 化物中に含まれるセルは、直径0.05~0.5mmの 範囲内にあった。

## [0029]

【比較例1】比較のため実施例1において、参考例3で 調製した熱可塑性シリコーン樹脂球状微粒子触媒の替わ りに、参考例1で調製した白金ピニルシロキサン錯体組 40 成物を白金金属として同一量となるような量を使用した 以外は上記と同様にしてシリコーンゴムスポンジ組成物 を得た。

【0030】この組成物を実施例1と同様にして硬化さ せて、スポンジ状硬化物を得た。この硬化物を切断し、 その切断面を上記と同様にして観察したところ、形成し たセルは、 $0.4\sim1$ 、2mmの範囲内にあった。ま た、このシリコーンゴムスポンジ組成物を室温にて24 時間放置した。しかる後、この組成物について上記と同 様の評価を行ったところ、得られた硬化物中に含まれる セルは、不均一な球状の揃わないセルであり、硬化物の 1部にはセルの発生が観察されなかった。

#### [0031]

【実施例3】ジメチルシロキサン単位99.85モル% とメチルピニルシロキサン単位 0. 15モル%からなる 両末端トリメチルシロキシ基封鎖オルガノポリシロキサ ン生ゴム(重合度3000)100部、ヒュームドシリ  $0.5\sim0$ .  $3\,\mathrm{mm}$ の範囲内にあった。また、このスポン 10 カ(日本アエロジル株式会社製、商品名アエロジル2.00) 、粘度80センチポイズの両末端シラノール基封鎖 ジメチルポリシロキサン10部を均一混合して、150 ℃で1時間加熱混合処理した。得られた混合物を冷却し た後、この混合物100重量部にケッチェンプラック1 00部を添加して均一に混合した後、さらに参考例3で 調製した熱可塑性シリコーン樹脂球状微粒子触媒 0.6 部と1-エチニール-1-シクロヘキサン0.02部と 粘度5センチポイズの両末端トリメチルシロキシ基封鎖 ジメチルシロキサンメチルハイドロジェンシロキサン共 【実施例2】実施例1において、参考例3で調製した熱 20 重体(ケイ素原子結合水素原子含有量0.8重量%)を 1. 5部を添加して混合した後、さらに分解温度122 ℃のアゾジカルポンアミドとジニトロソペンタメチレン テトラミンの混合物からなる発泡剤〔永和化成工業株式 会社製,商品名ピニホールAK#2]を2.0部添加し 均一混合してシリコーンゴムスポンジ組成物を得た。

【0032】この組成物を200℃のオープンに入れ、 加熱硬化させたところ、スポンジ状硬化物が得られた。 この硬化物を切断し、その切断面を顕微鏡にて観察した ところ、硬化物中に含まれるセルは、直径0.05~ (JIS A) であった。また、上記で得られたシリコ 30 0.2 mmの範囲内にあった。また、このスポンジ状硬 化物の発泡倍率は、1、9倍であり、その硬さは17~ 18 (JIS A) であった。

## [0033]

【実施例4】実施例1において、分解温度122℃の発 泡剤の替わりに分解温度160℃のアゾジカルボンアミ ドからなる発泡剤〔永和化成工業株式会社製商品名、ビ ニホールDW#6]を使用した以外は実施例1と同様に してシリコーンゴムスポンジ組成物を得た。

【0034】この組成物を実施例1と同様にして硬化 し、実施例1と同様にして、硬化物中に含まれるセルを 測定した。その結果、硬化物中に含まれるセルは直径 0. 08~0.5mmの範囲内にあった。

## [0035]

【発明の効果】本発明のシリコーンゴムスポンジ組成物 は、(A) 成分~(E) 成分からなり、特に、(E) 成 分の熱可塑性樹脂微粒子触媒を含んでいるので、可使時 間が長く、硬化後は均一で微細なセルを有するシリコー ンゴムスポンジになり得るという特徴を有する。